

两部门启动2026年“吃货季”食品提质扩需工作

本报讯 为深入贯彻党中央、国务院关于优化提升传统产业、大力提振消费的决策部署,加快建设现代化食品产业体系,以特色化、品牌化、国际化发展激发市场活力,以高质量供给扩大有效需求,近日,工业和信息化部、市场监管总局印发通知,联合组织开展2026年“吃货季”食品提质扩需工作。

据悉,2026年“吃货季”食品提质扩需工作主要包括以下四项重点任务。

一是深化产销对接合作,构建高效协同供应链体系。围绕食品产业链上下游协同需求,组织开展产销对接会、产业发展博览会等活动,打破产销信息壁垒,推动原料生产、加工制造、流通销售、市场服务等环节深度融合,构建高效协同新范式,提升供应链效率和消费市场服务能力。同时,鼓励中国消费名品企业积极参加相关活动,集中展示中国消费名品新理念、新行动、新成果。

二是丰富食品消费场景,打造多元融合消费新模式。顺应消费升级趋势,结合重要节假日与季节消费特点,开展主题消费活动,构建“线上+线下”“体验+服务”多元化消费模式。鼓励商圈、景区、特色街区打造“美食消费场景”,融合餐饮体验、文化展示、休闲娱乐等元素,提升趣味性和参与感,打造消费新场景新热潮,发展兴趣消费、体验经济。支持主流电商平台设立中国消费名品专区,推动中国消费名品线上线下多渠道推广。

三是挖掘区域特色资源,培育差异化食品产业集群。促进食品消费和文旅经济融合发展,开发具有



地方文化特色的美食产品与体验项目,培育美食文化旅游目的地。指导地方立足资源禀赋,产业基础,因地制宜做强做优传统优势食品产业和地方特色食品产业,促进集群协同发展,推动地方特色食品融入全国统一大市场,构建“百花齐放”发展格局。

四是强化品牌培育推广,打造食品产业优质品牌矩阵。挖掘活化非遗美食、特色品牌、中国消费名品,推动传统品牌年轻化、国潮化、场景化、名品化升级,扩大特色和创新能力供给。支持食品生产企业利用展会活动,加强品牌策划、形象设计、IP打造,丰富品牌文化内涵,推动品牌从产品标识向品质象征、文化符号、消费信任转变,引导消费新潮流、新方向。

为保障此项工作顺利实施,通知提出四点工作要求。

一是加强组织协调。各主办单位要按照《2026年“吃货季”食品提质扩需工作计划表》安排,精心做好活动筹备,认真做好项目落实。各地工业和信息化主管部门、市场监管部门要加强与主办单位沟通对接,统筹推动“吃货季”活动落地见效。工业和信息化部门工业文化发展中心做好“吃货季”启动和总结、食品文化巡礼等工作。

二是做好宣传推广。各相关单位要整合宣传资源,构建多渠道、立体化宣传体系。利用多媒体矩阵宣传“吃货季”活动意义、进展与成效;邀请美食博主、行业专家、媒体记者等参与活动报道,打造话题热点,提

升公众知晓度与参与度,着力营造全社会关心食品产业、支持产业发展的良好舆论氛围。

三是狠抓落地见效。各主办单位要压实主体责任,明确活动目标,活动举办时要积极关注企业参与情况、消费者反馈、经济数据等信息。各地工业和信息化主管部门、市场监管部门要积极发掘典型案例、总结推广成功经验,有关情况及时报送。

四是严守安全底线。各相关单位要规范有序开展活动,指导食品生产销售企业及餐饮服务经营者按照食品安全“四个最严”要求,抓实活动全流程食品安全风险排查、隐患管控与防范处置,切实保障人民群众“舌尖上的安全”。 (文 编)

一批高新技术等领域重要国家标准发布

本报讯 国家市场监督管理总局日前透露,市场监管总局(国家标准委)近日批准发布389项重要国家标准,涉及高新技术领域、传统产业、生态环保、农业生产、百姓生活等方面。

在高新技术领域,发布人工智能、网络安全、区块链等33项国家标准,发布工业互联网、工业数字孪生等6项国家标准,发布航天器接地要求、载人航天器标志及使用要求、民用轻小型旋翼无人机降落伞系统通用要求等15项国家标准。

在传统产业方面,发布冷拔异型钢管、热轧型钢等40项国家

标准,引领高端金属材料质量提升;发布泡沫镍、钨粉、铟锭等36项国家标准,助力新材料产业高质量发展。

在生态环保方面,发布电动汽车充电、风电场、光伏组件等5项国家标准;发布彩晶装饰玻璃、建筑用太阳能光伏中空玻璃等53项国家标准,促进绿色建材普及与建筑节能降碳。

在百姓生活方面,发布人工与智能客户服务协同国家标准,明确人工客服与智能客服协同工作的总体要求,以及呼入和呼出任务分配、客服切换、协同服务改进等具体要求。(辛 文)

中国与印度尼西亚主管部门间第十二次卫星网络协调会谈举行

本报讯 6月8—12日,工业和信息化部无线电管理局与印度尼西亚无线电主管部门在印度尼西亚日惹举行第十二次卫星网络协调会谈。

双方在国际电信联盟《无线电规则》框架下,就高低轨多个卫星系统的100余项议题开展磋商,涉及卫星通信、卫星气象、北斗短报文等多种业务。双方充分交换意见并达成多项共识,共同签署了会议纪要。会谈的成功举办,促进了两国卫星系统的频率兼容共用,有助于加快我国卫星网络国际协调进程,推动我国航天工程建设。

本次会谈,中方代表团由工业和信息化部无线电管理局、国家无线电频谱管理中心、国家卫星气象中心、北京跟踪与通信技术研究所以、中国卫星网络集团有限公司、中国卫通集团股份有限公司、上海垣信卫星科技有限公司,以及香港通讯事务管理局办公室、亚太通信卫星有限公司、亚洲卫星有限公司等单位组成。印尼代表团由印度尼西亚通信和数字事务部卫星频谱规划与轨道管理局、印度尼西亚电信公司、印度尼西亚人民银行、PSN卫星公司、PT SMA公司等单位组成。(伍 观)

坚持制造业当家 加快推进新型工业化

(上接第1版)深挖现有企业增资扩产意愿,推动企业加大投资力度,截至4月底,已推动153个亿元以上增资扩产项目签约,173个亿元以上增资扩产项目开工建设。例如,具身智能领域围绕机器人“大脑”、整机、关键零部件、应用等产业链图谱,梳理目标企业开展重点对接;生物医药领域按照“机制建立—基础夯实—重点攻坚—总结固化”分阶段明确关键节点和工作安排,重点抓好“逐个企业制定招商工作计划、编制医药和医疗器械产业招商地图”等10项任务;固态电池领域充分发挥国家新型储能创新中心作用,突出“链主招商、平台招商、产业链招商”,梳理产业链重点招引目标。

开展“广货行天下”系列活动 积极帮助企业开拓市场

大力开展“广货行天下”,牵头举办14场to C促销活动、16场to B活动,带动地州市举办各类促销活动超50场,覆盖家电、手机、消费电子、灯饰、皮革制鞋、服装、食品、玩具、珠宝首饰、智能卫浴等产业,主题新闻报道全平台浏览量超10亿,有力提升了“广货”影响力。加强链主企业供需对接,围绕新能源装备、集成电路、低空经济、纺织服装等重点产业,推动制造企业与产业链上下游企业、采购商对接,启动开展47场供需对接活动。用好84个制造业领域专业展会,借助展会资源支持企业开拓市场。春季广交会期间,工信系统组建专班协助促成企业意向订单超9000项、意向金额超86亿元。强化工贸联动,印发《广东省增强消费品供需适配性 进一步促进消费行动方案》;积极推动产销对接,推动与京东、阿里国际、拼多多等电商平台,以及沃尔玛、亚马逊等采购平台建立长效合作机制;举办制造业品牌出海专场,助力企业扩大海外市场销售。

全面打造制造业赋能体系 赋能重点产业、集群等发展

全面启动赋能工作,以AI为核心引擎,围绕微笑曲线“研发创新—制造生产—品牌建设—市场销售”构建全链条制造业赋能体系。

召开全省制造业赋能推进会,正式上线广东省制造业赋能线上对接平台“粤智赋”,发布《广东省制造业赋能资源管理办法》,开展第一批制造业赋能资源遴选。建立赋能长效机制,加快制定《广东省制造业赋能工作机制》,省市合力、条块结合,持续推进赋能对接,已开展超50场对接活动,达成合作意向超100项。加快推动组建赋能“翻译官”团队,深入企业提供精准赋能服务。在AI赋能软件产业领域先行先试,推动腾讯、钛动科技等自研AI编程助手、营销智能体,全方位赋能软件研发全流程,实现营销素材规模化、高品质、定制化产出,有效破解行业痛点。

抢抓人工智能发展机遇 推动软信业优质高效发展

今年以来,广东省工信厅密切对接软信业重点企业,引导企业优化在粤业务布局,开展“云壮+云回归”行动,推动一批AI算力云、智能体软件等项目落地。1—4月,广东软件和信息服务业营收同比增长9.8%。推动开源鸿蒙生态发展多点开花,印发《广东省推进国产操作系统生态发展壮大实施方案》,推动全国首个省级开源鸿蒙生态赋能公共服务平台——广东省开源鸿蒙适配中心在广州黄埔正式揭牌运营,搭载原生鸿蒙终端设备已突破5000万台。积极争取国家支持,成功争取工信部在深圳设立国家级互联网骨干直连点;广东14个万兆光网试点项目通过工信部评审,数量居各省份第一;珠海、惠州、中山3个城市入选工信部5G应用“扬帆”行动重点城市。加大政策宣贯力度,举办2026年全省软件和信息技术服务业政策培训会及工作座谈会,覆盖软信企业超1000家。

接下来,广东工信系统将认真落实中央及省“十五五”规划,继续发挥制造业底子厚实、配套齐全、反应敏捷的优势,抓紧抓细抓实高质量发展各项工作,一体推进传统产业、新兴产业和未来产业发展,推动产业科技互促双强,加快建设更具有国际竞争力的现代化产业体系,提升产业链现代化水平,坚定扛起“走在前、做示范、挑大梁”的责任担当。

(上接第1版)“短期内,为缓解‘通信堵点’,催生了1.6T光模块在2026年的规模商用,产业链业绩确定性极强。长期来看,技术正在向‘光通信3.0’演进,未来将走向全封装光学(CPO)以突破功耗极限,全光交换(OCS)以重构网络架构,铜缆在AI高速互联领域已进入淘汰倒计时。”彭灵勇说道。

快速攀升的需求,导致供给端短板日益凸显。一方面,AI集群所需的光模块数量,通常是普通数据中心的3~5倍;另一方面,国内骨干网络已有近半数设备升级为800G,各大算力枢纽和头部智算中心也基本用上了800G网络,加上北美云厂商、英伟达等企业定下了直到2028年的大额长期订单,海内外需求同步走高,国内相关产能一直满负荷生产。

“当前光通信行业呈现市场扩容与产能短缺并存的态势,高盛预测光互联市场将在2~3年内从150亿美元扩张至1540亿美元,但高端EML光芯片、磷化铟衬底等上游核心材料供给紧缺,二者供需缺口分别超过30%和70%。”彭灵勇谈及行业现状时说道。

具体来看,这种供货紧张并不是简单的短期产能调配问题,而是长期形成的结构性难题。以生产光芯片必备的磷化铟晶圆为例,一条6英寸晶圆产线的投资额就超过10亿元,不仅造价高昂,建设、扩产的周期也相当漫长。同时,再叠加高端芯片量产良率偏低、光电协同设计能力有待提升等问题,进一步放大了市场缺口。

而这样的行业现状,也给本土产业链留下了宝贵的成长和迭代机会。短期之内,整个行业的核心任务是消化海量订单、缓解供货压力;长期来看,全行业都会朝着更低功耗、更高带宽、更高集成度的方向持续升级。本土产业链也将借着这一轮行业变革的东风,稳步补齐短板、打磨技术,持续提升自身竞争力。

本土产业链分层明显 高端赛道迎来窗口期

市场供需的持续变化,倒逼国内光芯片企业不断打磨实力。经过多年技术积累与市场打磨,本土光芯片产品形成了清晰的梯队形态:中低端产品已经站稳市场,高端产品仍处在加速追赶的阶段。而当下,整个行业也正迎向来向高端领域

突破的宝贵窗口期。从实际应用和市场表现来看,产品分层的特征十分直观。面向常规通信场景的低速光芯片,本土技术、产能、供应链已经发展得十分成熟,完全可以满足市场需求。

应用范围更广的10G光芯片,本土产品市场份额可观,批量交付能力经过了长期市场检验,运行稳定可靠。

而聚焦AI算力集群、高速互联场景的25G及以上高速光芯片,是目前行业发力的重点。这类芯片也是支撑万卡级GPU集群运转的核心硬件,现阶段本土相关产品市场占比仅4%~5%,依旧存在不小的提升空间。

针对网上流传的“光芯片整体国产化率达70%”这一说法,彭灵勇作出客观澄清:“这通常是将中低端产品及无源器件等计入统计的结果,并不适用于AI所需的高端有源芯片场景。”

正如彭灵勇所言,高端赛道是本土产业接下来集中攻坚的核心方向。

目前行业面临的是一系列系统性难题:除了高端芯片设计制造能力有待加强之外,行业还普遍存在高端产能紧张、量产良率不足、核心材料供给受限等问题。与此同时,上游DSP电芯片等关键配套器件对外依赖度较高,也成为制约整条产业链向上突破的一大阻碍。

综合来看,本土光芯片产业如今是“基础扎实、短板尚存、机遇在前”。中低端产品筑牢了市场根基,高端产品虽仍有差距,但在市场需求、政策支持、技术创新的多重助力下,向上突破的条件已经成熟。2026—2027年,也将是本土产业冲刺高端赛道的黄金时期。

前沿技术待突破 多元路线勾勒产业未来

本土光芯片产业要真正站稳高端市场,核心比拼的是技术创新。目前整个行业摸索出三条主流发展路线,国内企业、科研团队齐头并进,在新材料、设备架构、集成封装上不断取得新进展。多样的技术方向,不仅解决了当下的行业难题,也清晰描绘出整个赛道的发展态势。

第一条发展路线是薄膜铌酸锂,被视为新一代“芯片原料”。

近性能天花板,传输慢、耗电多的问题越来越突出。在这样的背景下,薄膜铌酸锂成为业内公认的新一代优质材料,也是国内发力的重点方向。

谈及薄膜铌酸锂的技术优势,图灵量子高级产品总监杨志伟向《中国电子报》记者表示:“基于硅光的光通信,带宽上限就60GHz,想要做到100G就需要异质集成,目前还在实验室阶段。而薄膜铌酸锂很轻松就可以达到100GHz以上,这是它的一个天然优势,同时光学插入损耗更低,调制效率更高、驱动功耗更小,更契合高速算力集群的超高速、低功耗光互连需求。”

除了技术优势,薄膜铌酸锂的成本优势也将随着8英寸薄膜铌酸锂晶圆的量产而逐步释放。为了让这项技术快速落地,国家级创新平台、高校研究院所与骨干企业联合共建公共代工与中试平台,统一制定生产工艺标准,帮助行业提升良率,让更多企业能参与研发生产。目前业内也分成了两种研发思路:一部分团队专注做独立芯片产品,还有一部分尝试把它和成熟的硅材料结合,取长补短。

2026年被业界视作薄膜铌酸锂的量产元年。今年3月举办的全球光通信大会(OFC)形成共识:800G及以下光模块,用硅光、磷化铟可以满足需求;但1.6T、3.2T高速光模块和CPO共封装技术,都离不开薄膜铌酸锂。过去它仅用于试验、难以量产,现在工艺大幅进步,产品已批量走向市场。预计2027—2028年,3.2T光模块产品逐步普及,薄膜铌酸锂也会成为行业标配,商用价值全面释放。

第二条发展路线是LPO,其核心技术是简化设备结构,走出一条特色发展路。

LPO技术的核心思想是做减法,它保留了传统可插拔光模块的形态,去掉了模块内部最耗电、最昂贵的DSP芯片,用更简洁的组合完成数据传输工作,具有低功耗、低成本、低时延、易维护的特点。

LPO技术具有以下几个优点:第一,低功耗。根据半导体产品供应商MACOM的数据,具有DSP功能的800G多模光模块的功耗可超过13W。而利用MACOM PURE DRIVE技术的800G多模光模块功耗低于4W,下降70%。第二,低成本。有业界机构分析,800G光模块中,BOM成本约为600~700美金,DSP芯片的成本约为50~70美金,去掉该芯片能有效降低成本。第三,